

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2023-032

天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年10月20日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分监事和高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已通过公司董事会审计委员会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

（三）审议通过《关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已通过公司董事会审计委员会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日